证券代码：688049　证券简称：炬芯科技　公告编号：2026-010

炬芯科技股份有限公司
关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意炬芯科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3301号），本公司由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”、“保荐机构”）采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票3,050.00万股，发行价为每股人民币42.98元，共计募集资金131,089.00万元，坐扣承销和保荐费用9,042.09万元（不含增值税）后的募集资金为122,046.91万元，已由主承销商申万宏源承销保荐于2021年11月24日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,560.30万元（不含增值税）后，公司本次募集资金净额为119,486.61万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕7-124号）。

（二）募集资金累计使用金额和结余情况

截至2025年12月31日，公司募投项目实际使用募集资金54,027.40万元，使用超募资金回购股份5,540.55万元（含交易费用），使用超募资金永久补充流动资金25,000.00万元，募集资金余额为41,363.05万元（包括累计收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额）。公司2025年度募集资金使用情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元　币种：人民币

发行名称	2021年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2021年11月24日
本次报告期	2025年1月1日至2025年12月31日
项目	金额
一、募集资金总额	131,089.00
其中：超募资金金额	84,332.79
减：直接支付发行费用	11,602.39
二、募集资金净额	119,486.61
减：	
以前年度已使用的募集资金金额	67,946.63
以前年度募集资金理财收益与手续费支出的净额	-5,306.45
以前年度垫付的利息	406.71
本年度使用金额	14,306.81
银行手续费支出及汇兑损益	0.95
其他-用超募资金回购股份	2,314.51
加：	
募集资金利息收入	1,138.90
其他-收到垫付的利息	406.71
三、报告期期末募集资金余额	41,363.05

注1：收到的垫付利息是指大额存单到期收回前期预付的利息。

注2：上述表格数据如存在尾差系四舍五入计算所致。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《炬芯科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构申万宏源承销保荐分别与中信银行股份有限公司珠海分行、交通银行股份有限公司珠海分行、招商银行股份有限公司珠海分行、平安银行股份有限公司珠海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；同时，本公司及子公司合肥炬芯智能科技有限公司（以下简称“合肥炬芯”）、申万宏源承销保荐与招商银行股份有限公司珠海分行、交通银行股份有限公司珠海分行、平安银行股份有限公司珠海分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议及四方监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司及合肥炬芯在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，本公司有10个募集资金专户、15个募集资金理财户，1个股份回购专户，募集资金存放情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元　币种：人民币

发行名称			2021年首次公开发行股份		
募集资金到账时间			2021年11月24日		
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
炬芯科技	交通银行	440000091013000513090	0.08	使用中
合肥炬芯	招商银行	656900807310888	201.07	使用中
炬芯科技	中信银行	811090101290133565	80.00	使用中
合肥炬芯	交通银行	440000091013000650586	0.01	使用中
炬芯科技	招商银行	656900796910725	0.03	使用中
炬芯科技	平安银行	15006880490188	88.43	使用中
炬芯科技	招商银行	656900796910000	205.01	使用中
炬芯科技	中信银行	811090101250182444 8	54.05	使用中
合肥炬芯	招商银行	656900807310000	8.63	使用中
合肥炬芯	平安银行	15018088888895		使用中
炬芯科技	广发银行	95508802224260004 20	0.08	使用中
炬芯科技	浦发银行	19610078801000022 27	0.14	使用中
炬芯科技	厦门国际	8017100000018828	2.99	使用中
炬芯科技	华润银行	211225251793900002	0.37	使用中
炬芯科技	平安银行	15284199688049	0.22	使用中
炬芯科技	工商银行	2000207009100053165		使用中
炬芯科技	富邦华一	6000006081001188 0	0.48	使用中
炬芯科技	申万宏源证券	2015051546		使用中
炬芯科技	中信证券	8870420001 6	0.04	使用中
炬芯科技	中金财富证券	6697801488		使用中
炬芯科技	银河证券	339000031732		使用中
炬芯科技	玉山银行	000281000015643	0.01	使用中
炬芯科技	民生银行	640637871		使用中
炬芯科技	广发证券	31115586		使用中
炬芯科技	国泰海通证券	257289		使用中
炬芯科技	中信证券	3510000825		使用中
合肥炬芯	平安银行	15593078640034		已注销
炬芯科技	平安银行	15085785600076		已注销
炬芯科技	国信证券	250000209773		已注销
合 计			641.65	

注1：该表合计金额与实际结余募集资金41,363.05万元相差40,721.40万元，系用于购买未到期的大额存单、收益凭证、结构性存款及国债逆回购。

注2：开立于平安银行股份有限公司珠海分行营业部（账号：15593078640034、15085785600076）的募集资金专户对应的募投项目“发展与科技储备资金”已于2025年12月按计划完成投入，且账户中的募集资金均已使用完毕，为便于对募集资金专项账户进行管理，公司已于报告期内注销以上账户。公司在国信证券股份有限公司（账户账号：250000209773）购买的理财产品已全部到期赎回，且不再使用上述账户，公司已于报告期内办理完毕上述理财产品专用结算账户的注销手续。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

1、截至2025年12月31日，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币54,027.40万元，参见附件：募集资金使用情况对照表。

2、募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

3、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

（1）公司研发中心建设项目和发展与科技储备基金不单独产生经济效益，对公司间接产生经济效益。研发中心建设项目及发展与科技储备基金将以公司现有主营业务为基础，围绕未来战略规划，科学布局研发方向，进一步提升产品实力，增强公司技术研发实力。

（2）超募资金永久补充流动资金无法单独核算效益，其项目成果体现在缓解公司资金压力，降低财务风险。

（3）股份回购项目无法单独核算效益。

（二）募集资金项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理的情况

2024年12月11日，公司召开了第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。同意公司在保证不影响募集资金使用计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币65,000.00万元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月之内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以滚动使用资金。

2025年12月11日，公司召开了第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。同意公司在保证不影响募集资金使用计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币45,000.00万元（含）的暂时闲置募集资金和最高不超过人民币160,000.00万元（含）的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月之内有效。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元　币种：人民币

发行名称			2021年首次公开发行股份		
募集资金到账时间			2021年11月24日		
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	尚未归还金额
炬芯科技	厦门国际	大额存单	保本固定收益型	1,000.00	2022/5/19	2027/5/19	1,000.00
炬芯科技	厦门国际	大额存单	保本固定收益型	1,000.00	2022/5/20	2027/5/20	1,000.00
炬芯科技	厦门国际	大额存单	保本固定收益型	1,000.00	2022/5/23	2027/5/23	1,000.00
炬芯科技	厦门国际	大额存单	保本固定收益型	1,000.00	2022/5/24	2027/5/24	1,000.00
炬芯科技	中信银行	大额存单	保本固定收益型	4,000.00	2023/2/23	2026/2/23	4,000.00
炬芯科技	富邦华一	大额存单	保本固定收益型	5,000.00	2023/12/18	2026/12/18	5,000.00
炬芯科技	富邦华一	大额存单	保本固定收益型	2,000.00	2023/12/29	2026/12/29	2,000.00
炬芯科技	华润银行	大额存单	保本固定收益型	2,000.00	2024/6/21	2027/6/21	2,000.00
炬芯科技	华润银行	大额存单	保本固定收益型	2,000.00	2024/9/26	2027/9/26	2,000.00
炬芯科技	交通银行	大额存单	保本固定收益型	15,000.00	2025/2/27	2028/2/27	15,000.00
炬芯科技	中金证券	收益凭证	保本浮动收益型	1,000.00	2025/9/12	2026/9/7	1,000.00
炬芯科技	中金证券	收益凭证	保本浮动收益型	1,000.00	2025/11/4	2026/2/2	1,000.00
炬芯科技	国泰海通	收益凭证	保本浮动收益型	1,000.00	2025/12/19	2026/6/22	1,000.00
炬芯科技	国泰海通	收益凭证	保本浮动收益型	1,000.00	2025/12/19	2026/9/21	1,000.00
炬芯科技	中信证券	国债逆回购	保本固定收益型	2,721.40	2025/12/31	2026/1/1	2,721.40

（五）使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在使用超募资金补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

公司于2024年12月26日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》，同意公司使用不超过40,936.87万元人民币的超募资金（含利息及现金管理收益）用于投资建设新项目，并根据项目建设进度分批次投入。上述议案已经2025年1月14日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过。具体项目名称及对应的投入金额如下：

超募资金使用情况明细表（用于在建项目及新项目）

单位：万元　币种：人民币

发行名称			2021年首次公开发行股份			
募集资金到账时间			2021年11月24日			
项目名称	项目类型	投资总额	计划投入超募资金金额	董事会审议通过日期	股东会审议通过日期
新一代端侧AI芯片研发及产业化项目	新项目	10,110.74	10,110.74	2024年12月26日	2025年1月14日
新一代智能无线音频SoC芯片研发及产业化项目	新项目	16,917.56	16,917.56		
研发中心建设项目	新项目	13,908.57	13,908.57		

报告期内，本公司不存在超募资金用于回购本公司股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，募投项目“发展与科技储备资金”已按照计划完成投入，且该项目在平安银行股份有限公司珠海分行营业部（账户账号：15593078640034、15085785600076）开立的募集资金专项账户均已使用完毕，为便于对募集资金专项账户进行管理，公司对上述募集资金专项账户进行注销。账户余额合计27.86元已转入对应公司基本户。除此以外，公司不存在将募集资金投资项目结余资金用于其他募集资金投资项目或者非募集资金投资项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

公司于2022年4月21日召开了第一届董事会第十次会议、第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用自筹资金支付募投项目款项后续以募集资金等额置换的议案》，为提高运营管理效率，在不影响募投项目正常进行的前提下，同意公司及子公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用部分自筹资金支付募投项目所需款项，并从募集资金专户划转等额资金至实施主体的基本户进行置换。

公司于2025年6月19日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用自有资金、银行承兑汇票、信用证及外汇等方式支付募投项目境外采购所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，进行境外采购时，在不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，根据实际需要，先行使用自有资金、银行承兑汇票、信用证及外汇等方式支付，后续定期统计自有资金、银行承兑汇票、信用证及外汇等方式支付的募投项目款项金额，并以募集资金等额置换。

报告期内，本公司募集资金投资项目未发生变更。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

报告期内，本公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，及时披露募集资金使用情况，不存在募集资金使用和管理违规的情况。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

经鉴证，天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为，炬芯科技公司管理层编制的《关于2025年度募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕69号）的规定，如实反映了炬芯科技公司募集资金2025年度实际存放、管理与实际使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

经核查，申万宏源证券承销保荐有限责任公司认为，公司2025年度募集资金存放、管理和使用符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规定的要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在违规改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

八、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明。

截至2025年12月31日，公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况。

附件：募集资金使用情况对照表

特此公告。

炬芯科技股份有限公司董事会

2026年3月30日

附表：

募集资金使用情况对照表

单位：万元　币种：人民币

发行名称			2021年首次公开发行股份								
募集资金到账日期			2021年11月24日								
本年度投入募集资金总额			16,621.32								
已累计投入募集资金总额			84,567.96								
变更用途的募集资金总额			不适用								
变更用途的募集资金总额比例			不适用								
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期（具体到月份）	本度现效益	是否达到预计效益	项目可性发生重大变化
智能蓝牙音频芯片升级及产业化项目	研发项目	否	12,674.70	23,835.61	23,835.61	5,978.20	24,360.23	524.62	102.20[注1]	2025年12月	不适用	不适用	否
面向穿戴和IoT领域的超低功耗MCU研发及产业化项目	研发项目	否	6,728.07	7,738.34	7,738.34	865.03	7,852.66	114.32	101.48[注1]	2025年12月	不适用	不适用	否
研发中心建设项目	运营管理	否	5,751.05	5,751.05	5,751.05		5,891.95	140.90	102.45[注1]	2024年7月	不适用	不适用	否
发展与科技储备资金	运营管理	否	10,000.00	10,000.00	10,000.00	2,432.26	10,891.25	891.25	108.91[注1]	不适用	不适用	不适用	否
超募资金永久补充流动资金	补流	不适用	不适用	25,000.00	25,000.00		25,000.00		100.00	不适用	不适用	不适用	不适用
超募资金回购股份	回购股份	不适用	不适用	5,540.55	5,540.55	2,314.51	5,540.55		100.00	不适用	不适用	不适用	不适用
新一代端侧AI芯片研发及产业化项目	研发项目	否	10,110.74	10,110.74	10,110.74	1,056.57	1,056.57	-9,054.17	10.45	2027年12月	不适用	不适用	否
新一代智能无线音频SoC芯片研发及产业化项目	研发项目	否	16,917.56	16,917.56	16,917.56	2,368.09	2,368.09	-14,549.47	14.00	2027年12月	不适用	不适用	否
研发中心建设项目	运营管理	否	13,908.57	13,908.57	13,908.57	1,606.66	1,606.66	-12,301.91	11.55	2027年12月	不适用	不适用	否
尚未确认投向的超募资金	不适用	不适用	不适用	684.19	684.19			-684.19		不适用	不适用	不适用	不适用
合计			119,486.61[注2]	119,486.61	119,486.61	16,621.32	84,567.96	-34,918.65	—	—		—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	不适用												
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用												
募集资金投资项目先期投入及置换情况	报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。												
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	2024年12月11日，公司召开了第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。同意公司在保证不影响募集资金使用计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币65,000.00万元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月之内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用资金。 2025年12月11日，公司召开了第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。同意公司在保证不影响募集资金使用计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币45,000.00万元（含）的暂时闲置募集资金和最高不超过人民币160,000.00万元（含）的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月之内有效。 截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金购买的大额存单、收益凭证、结构性存款及国债逆回购未到期金额合计40,721.40万元。												
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。												
募集资金结余的金额及形成原因	募投项目“发展与科技储备资金”已按照计划完成投入，且该项目在平安银行股份有限公司珠海分行营业部（账户账号：15593078640034、15085785600076）开立的募集资金专项账户均已使用完毕，为便于对募集资金专项账户进行管理，公司对上述募集资金专项账户进行注销。账户余额合计27.86元已转入对应公司基本户。												
募集资金其他使用情况	公司于2022年4月21日召开了第一届董事会第十次会议、第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用自筹资金支付募投项目款项后续以募集资金等额置换的议案》，为提高运营管理效率，在不影响募投项目正常进行的前提下，同意公司及子公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用部分自筹资金支付募投项目所需款项，并从募集资金专户划转等额资金至实施主体的基本户进行置换。 公司于2025年6月19日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用自有资金、银行承兑汇票、信用证及外汇等方式支付募投项目境外采购所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，进行境外采购时，在不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，根据实际需要，先行使用自有资金、银行承兑汇票、信用证及外汇等方式支付，后续定期统计自有资金、银行承兑汇票、信用证及外汇等方式支付的募投项目款项金额，再从募集资金专户支取相应等额款项，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。报告期内，公司使用募集资金置换部分自筹和自有资金支付募投项目资金10,956.79万元。 2024年6月21日，公司召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》，同意使用合计不超过人民币3,000.00万元的募集资金向全资子公司合肥炬芯智能科技有限公司提供无息借款用于实施募投项目。截至2025年12月31日，已累计提供借款1,682.08万元。 公司于2024年9月23日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用超募资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股股票，用于员工持股计划或股权激励。公司拟用于本次回购的资金总额不低于人民币2,250万元（含），不超过人民币4,500万元（含）。2025年度，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份588,036股，占公司目前总股本的0.336%，回购成交的最高价为49.76元/股、最低价为34.78元/股，支付的资金总额为人民币2,314.51万元（含交易费用）。 公司于2024年6月21日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》，同意使用合计不超过人民币3,000.00万元的募集资金向全资子公司合肥炬芯智能科技有限公司提供无息借款用于实施募投项目。截至2025年12月31日，已累计提供借款1,682.08万元。 公司于2024年9月23日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用超募资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股股票，用于员工持股计划或股权激励。公司拟用于本次回购的资金总额不低于人民币2,250万元（含），不超过人民币4,500万元（含），回购价格为不超过人民币30.00元/股（含），回购期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。公司于2025年3月31日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过《关于调整股份回购价格上限的议案》，同意将本次回购股份价格上限由不超过人民币30.00元/股调整为不超过人民币53.00元/股。2025年度，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份588,036股，占公司目前总股本的0.336%，回购成交的最高价为49.76元/股、最低价为34.78元/股，支付的资金总额为人民币2,314.51万元（含交易费用）。												

[注1]：该项目投入进度超过100%的原因系实际投入金额含收到的银行存款利息扣除手续费的净额。本专项报告部分表格中单项数据加总数与表格合计数可能存在微小差异，均系计算过程中四舍五入形成。

[注2]：公司首次公开发行时，募集资金净额为119,486.61万元，其中超募资金84,332.79万元。

公司代码：688049　　公司简称：炬芯科技

炬芯科技股份有限公司
2025年年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”部分，请投资者注意投资风险。

3、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

4、公司全体董事出席董事会会议。

5、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6、公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是　√否

7、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并报表归属于公司股东的净利润204,586,027.73元，截至2025年12月31日，母公司期末可供分配利润为239,201,666.65元。经董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣减回购专用证券账户的股份）为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.60元人民币（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本（扣减回购专用证券账户的股份）为174,280,495股，以此计算合计拟派发现金红利45,312,928.70元（含税）。2025年度，公司以现金为对价，采用集中竞价交易方式回购股份588,036股，支付的资金总额为人民币23,135,626.47元（不含印花税、交易佣金等交易费用），公司在2025年10月已实施2025年半年度现金分红，以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户的股份为基数向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），合计派发现金红利17,428,049.50元（含税），2025年半年度、年度现金分红和回购金额合计为85,876,604.67元，占本公司2025年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为41.98%。其中，以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称“回购并注销”）金额为0元，现金分红和回购并注销金额合计62,740,978.20元，占本公司2025年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为30.67%。

截至2025年12月31日，公司通过回购专用账户所持有本公司股份887,155股，不参与本次利润分配。

如在实施权益分派股权登记日前，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本（扣减回购专用证券账户的股份）发生变化，公司将另行公告具体调整情况。

母公司存在未弥补亏损

□适用　√不适用

8、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用　√不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

1.1 公司股票简况

√适用　□不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	炬芯科技	688049	不适用

1.2 公司存托凭证简况

□适用　√不适用

1.3 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	谢校辉	程奔驰
联系地址	珠海市高新区唐家湾镇科技四路1号1#厂房一层C区	珠海市高新区唐家湾镇科技四路1号1#厂房一层C区
电话	0756-3673718	0756-3673718
传真	0756-3392727	0756-3392727
电子信箱	investor.relations@actionstech.com	investor.relations@actionstech.com

2、报告期公司主要业务简介

2.1 主要业务、主要产品或服务情况

作为中国领先的低功耗AIoT芯片设计厂商，公司专注于中高端智能音频SoC芯片的研发、设计与销售，深耕无线音频、智能穿戴、智能交互等AIoT核心场景，为行业提供高集成度的专业芯片产品与一体化解决方案；公司坚定践行品牌客户战略，以持续高强度技术研发筑牢产品核心竞争力，推动市场份额稳步攀升。

依托全场景AI音频布局，公司已构建起低功耗大算力芯片硬件架构、高性能音频链路及音频算法、高带宽低延迟无线连接技术、便捷高效的端侧AI开发工具四大核心技术壁垒，并率先布局存内计算（CIM）技术、CPU+DSP+NPU架构实现AI算力高效加速，从底层架构突破传统计算模式的存储墙与功耗墙瓶颈，与端侧AI对高能效比、低功耗、实时推理的核心要求高度契合，形成软硬件协同、算法与连接技术深度融合的差异化优势。

未来，公司将围绕硬件升级、算法迭代优化、无线连接技术拓展、生态体系搭建四大核心维度持续加码研发投入，不断强化存内计算等前沿架构在智能音频终端的规模化落地优势，逐步拓展应用边界，致力于成长为端侧AI多领域的领先芯片供应商。

公司芯片产品用例展示：

公司的部分终端品牌客户：

注：公司已进入上述终端品牌的供应链，上述终端品牌在报告期内非公司的直接销售客户。

公司的核心产品：

（1）智能无线音频SoC芯片系列：公司的智能无线音频SoC芯片主要应用于蓝牙音箱、无线麦克风、智能穿戴设备、无线家庭影院音响系统、无线电竞耳机、无线收发dongle等。

（2）端侧AI处理器芯片系列：

公司致力于提供智能物联网AIoT端侧低功耗算力的芯片平台，聚焦于端侧AI技术在音频领域的深度落地与创新应用，可为声纹识别、智能降噪与人声增强、波束成形、定向拾音、人声分离、回声消除、去混响、反馈抑制、音效增强、声场定位与调校、定向传声、多音轨分离与重混（包括人声、乐器等）、人声美化、变声、灯效、智能场景识别、情感识别、语音唤醒与识别、语义分析等为代表的众多实际应用场景提供充足的AI算力，可广泛应用在以Party音箱以及声卡、调音台、专业麦克风、会议系统、无线家庭影院音响系统等为代表的专业音频设备中。

2.2 主要经营模式

作为集成电路设计企业，公司采用行业常用的Fabless经营模式，即专门从事集成电路的研发设计，晶圆制造和测试、芯片封装和测试均委托专业的集成电路制造企业、封装测试企业完成，取得芯片成品后对外销售。同时，为了缩短芯片产品的面市时间，降低客户的开发门槛，公司在提供SoC芯片的同时，提供完善的SoC软件开发平台（算法库、OS、SDK、应用软件和开发工具等），针对不同品类的特性以及市场需求，为客户提供融合软硬件和算法的整体解决方案。

1、研发模式

公司研发流程如下：

在立项阶段，各事业部根据市场调研情况提出市场需求，各研发部门根据市场需求文档提出各自领域的研发需求以及技术创新需求，由项目经理组织各部门进行需求的可行性评估和立项评审。当项目评审通过后，项目正式立项。

在研发阶段，各事业部及研发部门共同讨论并制定芯片的设计规格书，SoC研发部将根据设计规格书进行电路设计、仿真和验证、物理实现以及封装设计工作，完成所有工作后，召开Tape out评审会议；同时，系统研发中心和算法研发中心进行芯片应用方案的开发工作。在新产品Tape out评审会通过后，制造工程部委托晶圆制造厂、封装测试厂依照与量产流程相似的标准进行样品试生产，同时进行晶圆和封装测试环境的开发。样品完成后，各研发部门会进行芯片验证和样机测试，核实样品是否达到各项设计指标。

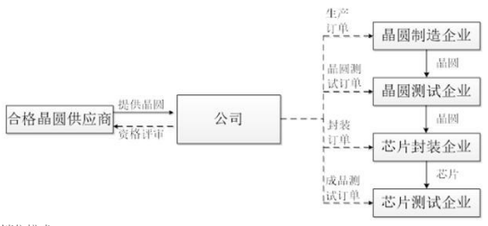
在新产品验证通过后，系统研发中心将发布应用方案级别的软件和硬件开发平台，开始进行客户端产品试量产。在试量产成功完成后，进入芯片量产阶段。

2、采购与生产模式

公司采用Fabless模式，主要负责集成电路的设计，因此需要向晶圆制造厂采购晶圆，向集成电路封装、测试企业采购封装、测试服务。

运营部依据业务部的出货预测制定相应采购计划和生产计划，并由晶圆制造厂和封装测试厂完成晶圆制造、晶圆测试、芯片封装测试等委外生产工作。此外，公司还会采购存储等配套芯片。

采购生产流程：



3、销售模式

根据集成电路行业惯例和自身特点，公司采用“经销为主，直销为辅”的销售模式，均为买断式销售。公司在销售过程中，除了提供SoC芯片，还可为